

01-关于ESWIN

半导体产业重要性

The Importance Of The Semiconductor Industry



工业的明珠

直接体现国家综合国力



国家大力扶植

年投资100~150亿美元



应用广泛

AI、无人驾驶、物联网等

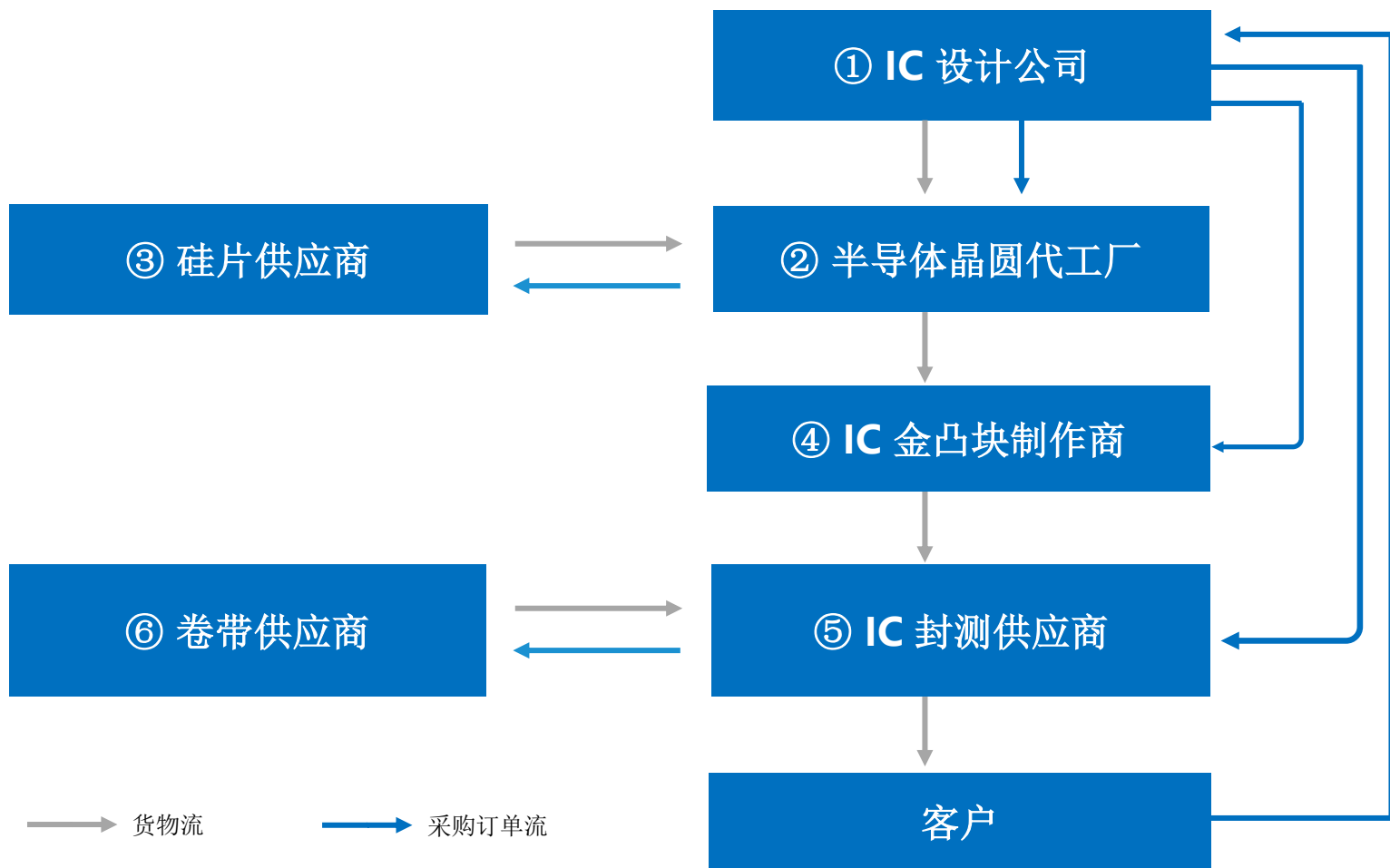
半导体产业结构

The Structure Of The Semiconductor Industry

ESWIN



ESWIN涉足
除晶圆代工外
的所有环节





600+

现有员工



8个

国家或地区



40%

硕士以上占比



20%

专家&核心人才



64%

海内外名校比例

公司大事记

Company Events

ESWIN



2016

2016年3月

北京奕斯伟成立

2016年8月

合肥奕斯伟芯片公司成立

2016年12月

成都奕斯伟芯片公司成立



2017

2017年7月

成都奕斯伟系统公司成立

2017年12月

芯片封测双子项目落户合肥

2017年12月

硅产业基地项目落户西安
总投资超过110亿元



2018

2018年1月

合肥奕斯伟材料公司成立

2018年2月

西安奕斯伟硅片公司正式成立

2018年4月

中国大陆首条最大的COF卷
带生产基地在合肥开工

2018年11月

卷带产业基地正式封顶



2019

2019年6月

集成电路设计研发基地落户海宁，
预计至2024年，集聚专业研发
及管理人员约3000人，实现销
售收入约30亿元。

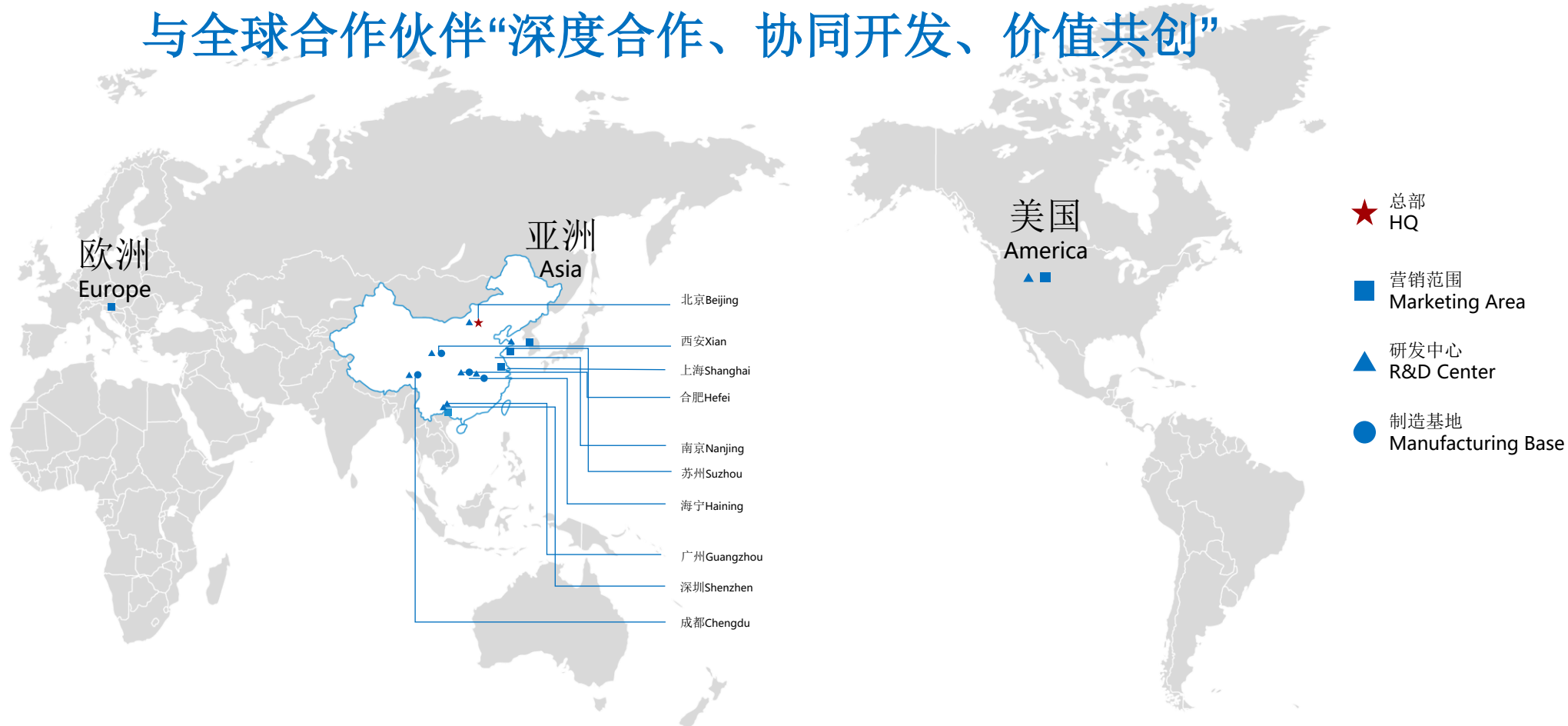
全球业务网络

Global Business Network

ESWIN

立足本地制造，以全球客户为导向

与全球合作伙伴“深度合作、协同开发、价值共创”





产品应用

显示驱动芯片、显示控制
芯片、AI芯片、IoT芯片



公司分布

北京、成都、合肥、西安、
南京、广州、海宁、首尔



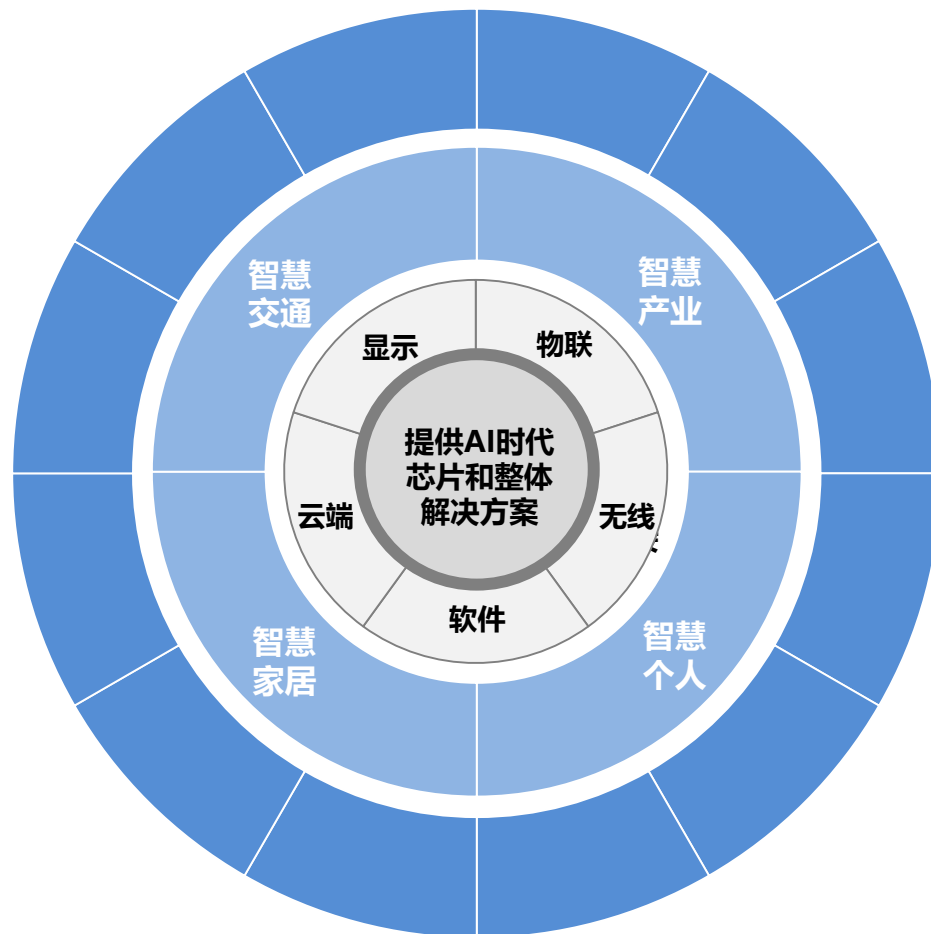
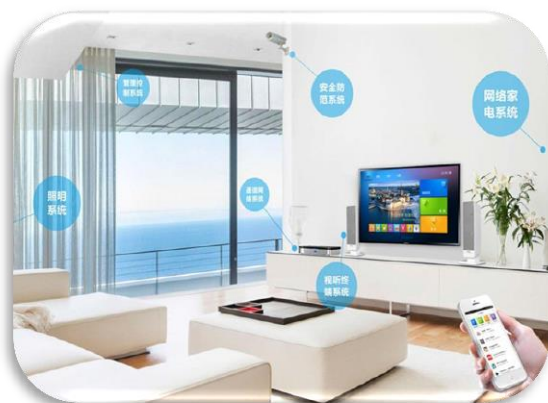
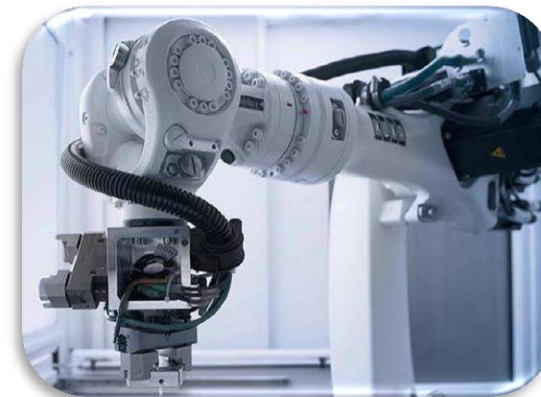
应用场景

智慧家居、智慧交通、
智慧个人、智慧产业

芯片设计

R&D of the Chip

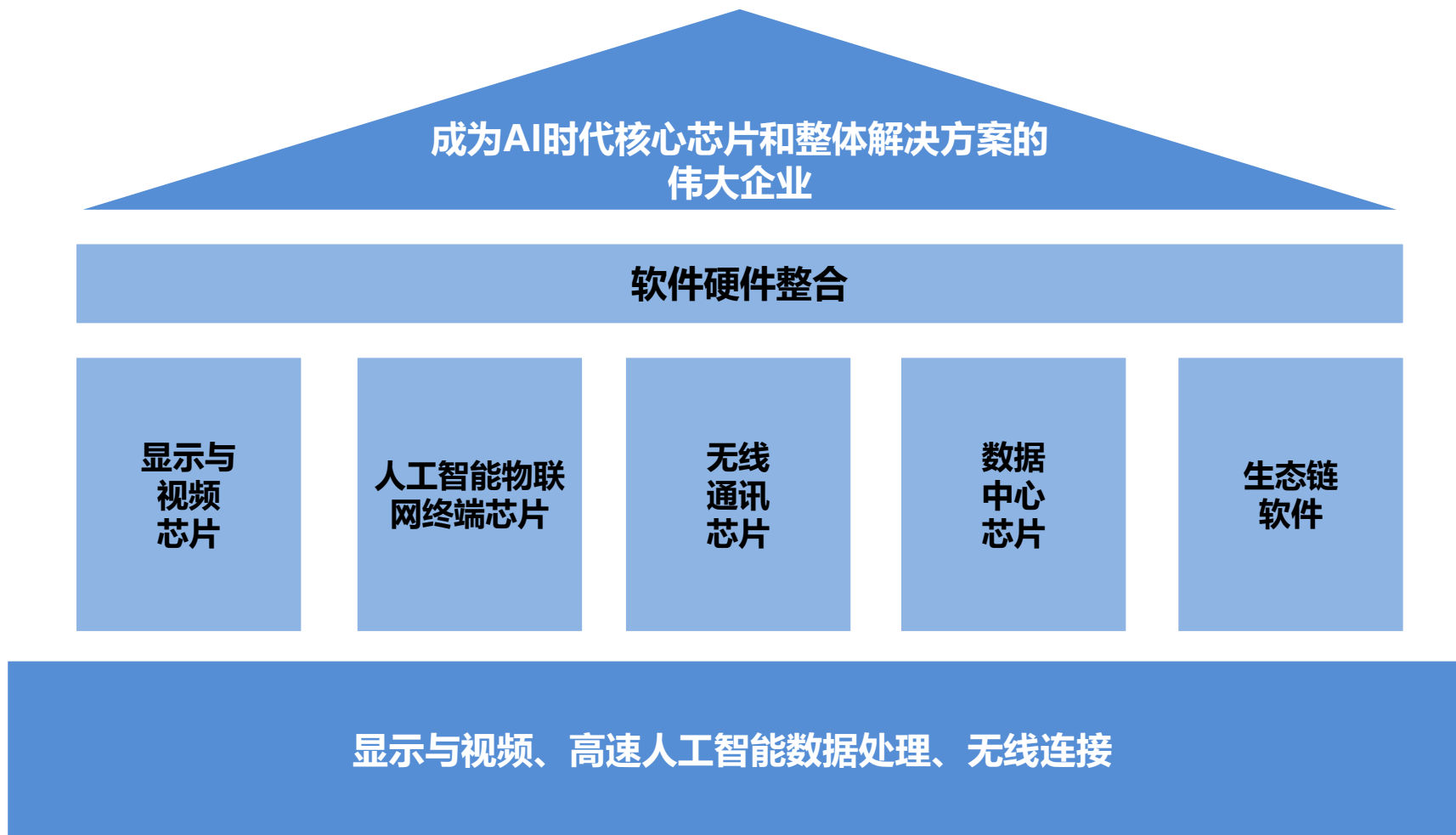
ESWIN



芯片设计

R&D of the Chip

ESWIN



先进封测

Chip Package & Test

ESWIN

合肥ESWIN

国内首条自主技术建设Film厂

ESWIN
China Hefei

Stemco

Korea Gyeongju

LGIT

Korea Gumi

Flexceed

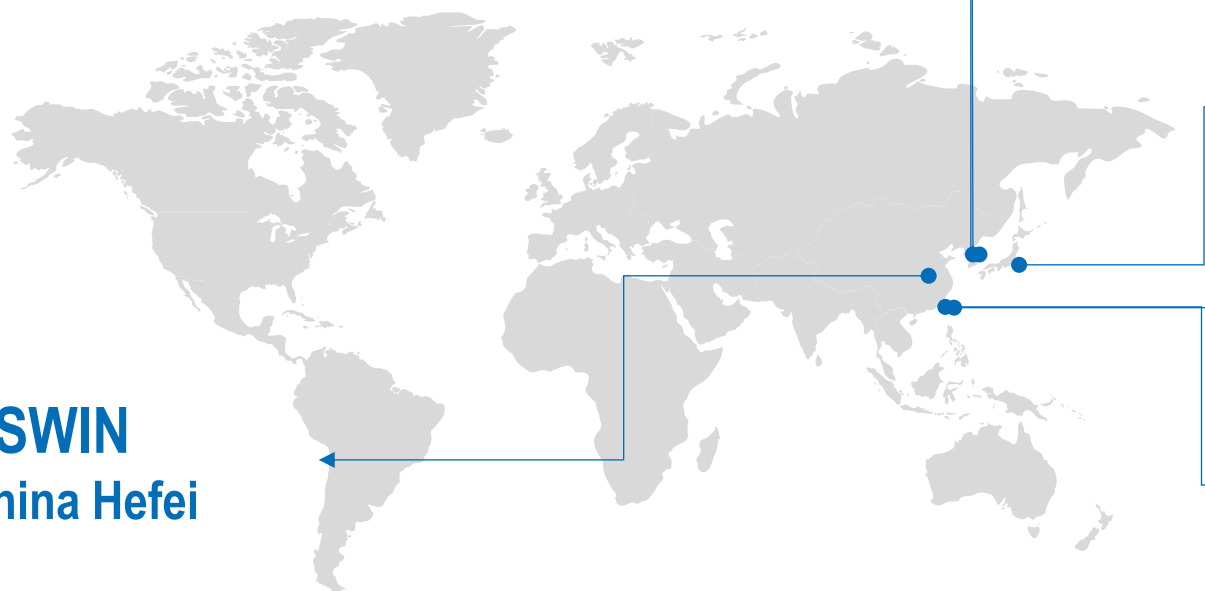
Japan
Ibaraki Prefecture

JMC

Taiwan Kaohsiung

Chipbond

Taiwan Kaohsiung



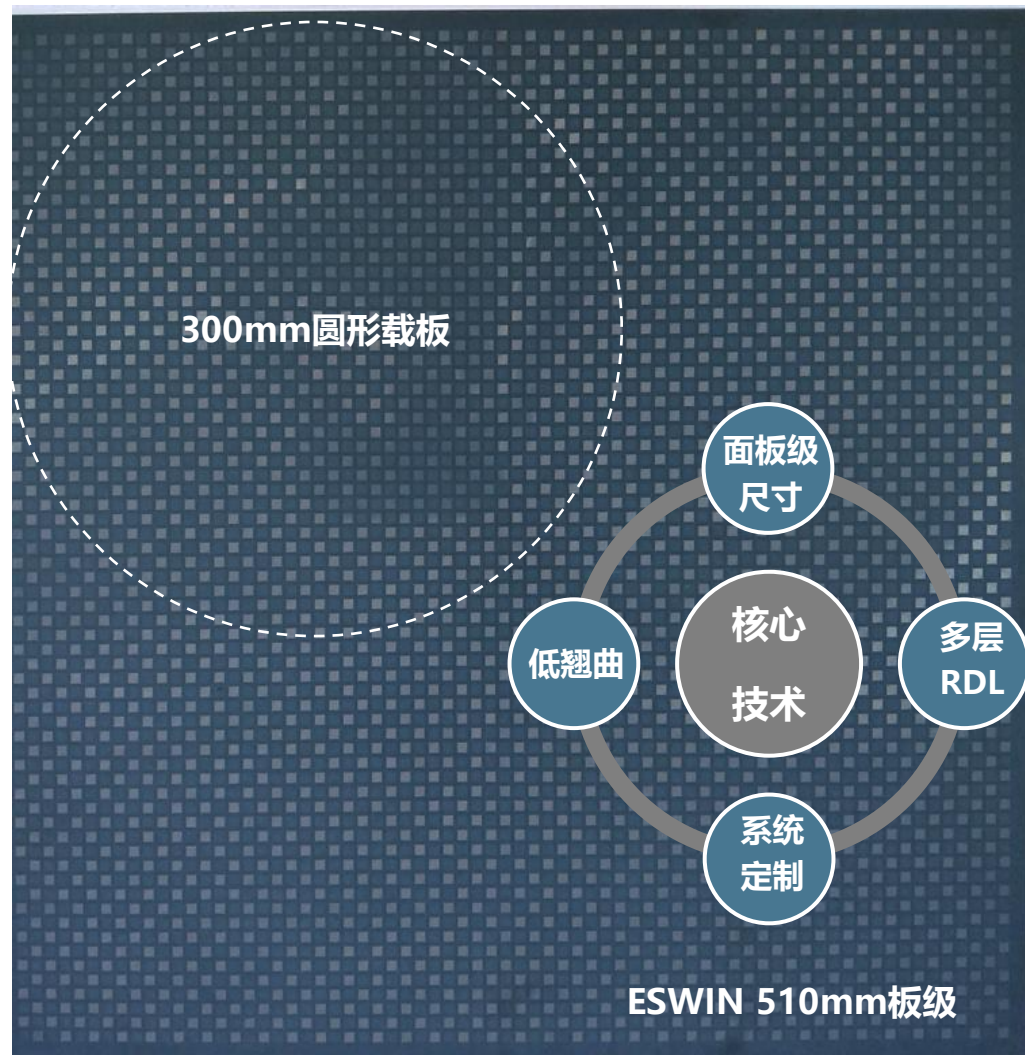
先进封测

Chip Package & Test

ESWIN

成都板级封装项目坐落于成都市高新西区，预计总投资70亿元，是国内首条板级先进封装量产线，目标客户定位于国际一线IC design house、Foundry厂、内部客户等。

ESWIN收购硅谷创新公司获得成熟的半导体封装技术方案，结合全球领先面板企业的高精度大屏技术，攻克大尺寸方形板级关键技术难点，为客户提供高性能、低成本的系统级解决方案。



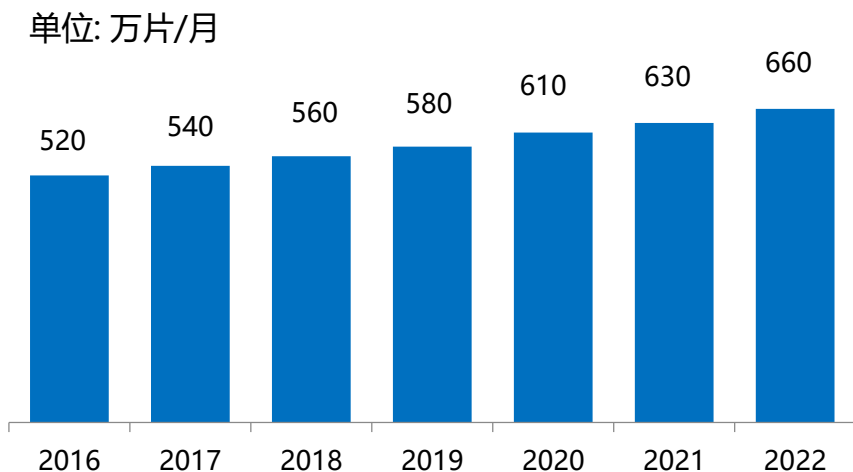
硅材料

Silicon Materials

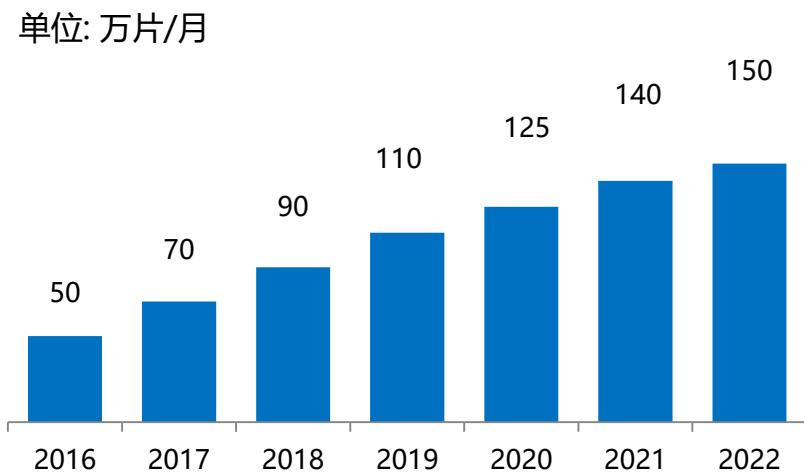
ESWIN

- 全球12英寸硅片需求量将持续增长，到2022年将达到660万片/月，年复合增长率4.1%；
- 中国大陆12英寸硅片需求量将保持迅速增长，到2022年将达到150万片/月，年复合增长率20.1%；
- 但目前中国大陆12英寸硅片全部依赖于进口，供需矛盾突出。

全球12英寸硅片月需求预测



中国大陆12英寸硅片月需求预测



硅材料

Silicon Materials

ESWIN

2017年12月，奕斯伟与西安市高新区签署合作协议，总投资约110亿元，项目于2018年5月中旬完成开工仪式，主要产品为12 硅片晶圆。2019年5月已开始设备搬入工作。

公司拥有一批外籍专家和经验丰富的技术研发团队，着力于半导体材料产品的研发制造，研发了300mm硅单晶生长、硅片加工、外延片制备、硅片分析检测等硅片产业化成套工艺，提升我国硅片制造水平。



硅材料

Silicon Materials

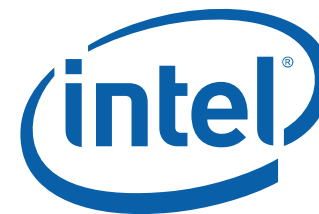
ESWIN

产品：

12寸抛光片、外延片

目标客户：

国际一流的半导体制造公司及晶圆代工厂



海宁项目介绍

Introduction to R&D Center

ESWIN

2019年6月，奕斯伟与海宁管委会签署协议，牵手共建集成电路设计研发基地，延伸培育集成电路设计等核心产业。

该项目拟落户鹃湖国际科技城孵化器基地，面积约6.5万平方米，内容包括人机交互、物联网及人工智能芯片IP及产品开发、销售，并建立相关研发实验室及数据中心，预计至2024年，集聚专业研发及管理人员约3000人，实现销售收入约30亿元。



海宁概况

Haining Overview

ESWIN

海宁地处长江三角洲南翼，浙江省北部，杭嘉湖平原南端，东距上海120公里，西与杭州接壤。陆地面积700.5平方公里，常住人口106万。

海宁历史悠久，文化灿烂，拥有天下奇观海宁潮，国家级非物质文化遗产硖石灯彩。“潮文化、灯文化、名人文化”三大文化交相辉映，素有“鱼米之乡、丝绸之府、皮衣之都、文化之邦、旅游之地”的美誉。





鹃湖国际科技城概况

Introduction to Juanhu Lake International Science Park

海宁鹃湖国际科技城位于海宁市区东部，规划面积23.3平方公里，围绕“生态化、国际化、智能化、高端化”的发展愿景，打造集科技成果转移转化示范区、创新平台集聚区、科技创业孵化区、人才引进培育区、产城融合宜居新区为一体的科技人文生态新城。

